

Express5800/R110K-1M スペック詳細

フレームモデル

2023年09月26日版

製品名称		Express5800/R110k-1M					
モデル名		8x2.5型ドライブモデル (U.3 NVMe x4/SAS/SATA)		8x2.5型ドライブモデル (U.3 NVMe x1/SAS/SATA)	4x3.5型ドライブ		
製品型名		N8100-2997Y		N8100-2998Y	N8100-2999Y		
CPU	Processor	インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3408U (8C/8T, 1.80GHz, 22.5MB ,TDP125W), Silver 4410Y (12C/24T, 2.00GHz, 30MB ,TDP150W), Silver 4416+ (20C/40T, 2.00GHz, 37.5MB ,TDP165W), Silver 4410T (10C/20T, 2.70GHz, 26.25MB ,TDP150W), Gold 5420+ (28C/56T, 2.00GHz, 52.5MB ,TDP205W), Gold 5412U (24C/48T, 2.10GHz, 45MB ,TDP185W), Gold 5415+ (8C/16T, 2.90GHz, 22.5MB ,TDP150W), Gold 6414U (32C/64T, 2.00GHz, 60MB ,TDP250W), Gold 6426Y (16C/32T, 2.50GHz, 37.5MB ,TDP185W), Gold 6442Y (24C/48T, 2.60GHz, 60MB ,TDP225W), Gold 6444Y (16C/32T, 3.60GHz, 45MB ,TDP270W), Gold 6434 (8C/16T, 3.70GHz, 22.5MB ,TDP195W)					
	標準搭載数 / 最大搭載数	0/1					
	コントローラ・ハブとの接続	DMI4 (16GB/s)					
	インテル® 64	対応					
	インテル® パーチャライゼーション・テクノロジー	対応					
	インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー	対応					
	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー	対応					
	CPUソケット形状	FCLGA4677					
	ホットプラグ	-					
	冷却方式	ファンなしヒートシンク					
チップセット		インテル® C741 チップセット					
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 2TB (16x 128GB)					
	メモリスロット数	16					
	増設単位	1 ⁷					
	搭載メモリ	DDR5-400 Registered DIMM (16/32/64/128GB)					
	最大動作周波数	4800MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)					
	メモリバス帯域(チャネルあたり)	38.4GB/s					
	メモリアクセス方式	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて16wayインターリーブをサポート)					
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC, ADDDC					
	メモリスベアリング	非対応					
	メモリミラーリング	対応					
	ホットプラグ	-					
	モジュールピン数	288 ピン					
	動作電圧	1.1V					
バックアップ機能	対応						
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵スロット	フロント	- 8x2.5型ドライブ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) - 2x2.5型増設ドライブ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) (オプション 最大1個)	- 8x2.5型ドライブ(U.3 NVMe x1/SAS/SATA) - 2x2.5型増設ドライブ(U.3 NVMe x4/SAS/SATA) (オプション 最大1個)	4x3.5型ドライブ	
			リア	-	-	-	
			ミドル	-	-	-	
		内部	-	-	-		
	内蔵標準	-					
		-					
	内蔵最大	2.5型HDD: SATA 10TB (10x 1TB), SAS 24TB (10x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 78TB (10x 7.68TB), SAS 78TB (10x 7.68TB), NVMe 78TB (10x 7.68TB) (オプション増設ドライブケース追加時)				3.5型HDD: SATA 72TB(4x 18TB), SAS 48TB(4x 12TB)	
		ホットスワップ	対応				
	インタフェース規格とRAID構成		N8103-243/245 SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション) N8103-244/246 SAS 22.5Gb/s, PCIe4.0(NVMe) 16GT/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)				
	光ディスクドライブ		内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) ¹				
FDD		オプション: Flash FDD (1.44MB) ²					
拡張ベイ		-					
拡張スロット	対応スロット	標準構成 1x PCI Express 5.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト、ハーフレングス) 1x PCI Express 5.0 (x16レーン, x16ソケット) (OCPスロット) (LOMカード、OCP RAID共用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)					
	規格	PCI Express 1.1, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0					
	グラフィックス	搭載チップ / ビデオRAM グラフィック表示 と 解像度	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200 1x USB3.2 Gen1(Type A), 1x USB2.0(Type A) (BMC用), 1x USB2.0(Type A)(N8154-180 内蔵DVDドライブ増設キット 搭載時)				
標準インタフェース	リア	2x USB3.2 Gen1(TypeA) , 1xアナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45) 2x 1000BASE-T LANコネクタ(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 RJ-45) 1x シリアルポート (オプション)					
	内部	1x USB3.2 Gen1(TypeA), 1x USB2.0(TypeA), 2x SATA 3.0					
ネットワーク	実装形式	オンボード					
	コントローラ	Broadcom BCM5720					
リモート	チームング	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)					
	ジャンボフレーム	対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)					
マネージメント	PXE / iSCSI ブート	PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応					
	コントローラ	NEC iLO6					
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)		Marvell PHY					
キーボード / マウス		対応					
BIOS Version (出荷当初)		オプション					
BMC Firmware Revision (出荷当初)		System ROM U63 v1.30 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)					
System Sleep State		1.30 (最新のリビジョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)					
冗長電源		S0, S5					
冗長ファン		対応 (オプション, ホットプラグ可)					
筐体デザイン		対応 (標準, ホットプラグ可)					
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)		1Uラックマウント					
質量 (最小/ 最大)		434.6mm × 605.2mm × 42.8mm (2.5 型ドライブモデル : フロントベゼル/レール/突起物含まず) 434.6mm × 664.7mm × 42.8mm (3.5 型ドライブモデル : フロントベゼル/レール/突起物含まず) 12kg/20kg (スライドレールの質量は含まれません)		13kg/21kg (スライドレールの質量は含まれません)			
電源	選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-159,160A,194) 500W 80 PLUS® Platinum/800W 80 PLUS® Platinum/1000W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-162A) 1600W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)						
	消費電力(100V最大構成時, 最大電力)		1097VA / 1097W (1000W 電源最大値) ^{*3}				
	消費電力(200V最大構成時, 最大電力)		1096VA/1093W *3				
省エネ法(2021年度基準)に基づくエネルギー消費効率 ^{*7}		15.8 (区分1)					
温度条件		動作時: 10～35℃(条件付きで5～45℃対応可) ^{*4} , 保管時: -30～60℃					
湿度条件		動作時: 8～90%, 保管時: 5～95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)					
ハードウェア認証規定		VCCI クラス A					
OS認証		Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware					
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル, スライドレール					
無償保証内容		3年オンサイト保守サービス(月～金, 9:00～18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)					
インストールOS		3年パーツ保証					
サポートOS	NECサポート	-					
		Microsoft® Windows Server® 2019 Standard , Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2022 Standard , Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 8.6以降(2023/10/26サポート開始予定) ^{*5} , VMware ESXi™ 7.0u3 以降(2023/10/26サポート開始予定), VMware ESXi™ 8.0u1 以降(2023/10/26サポート開始予定)					
動作確認OS ^{*6}		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います					

注意事項

拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで, ショートサイズ = 173.1mmまで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mmまで, MD2 = 167.6mmまで を示します

注釈

- *1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIを全システムに搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付DVD-ROMをシステムで最低1式は必ず手配してください。
*2 必要に応じて手配してください。主な用途については「Flash FDD製品概要と利用ケース」のシステム構成ガイドを参照下さい。
*3 CPU TDPごとの最大電力はシステム構成ガイドをご参照ください。
*4 40℃/45℃環境においてそれぞれ構成制限および環境制限があります。詳細はシステム構成ガイド「リファレンス」の「40℃/45℃環境での利用について」をご参照ください。
*5 サポートサービスの提供を受けるにはNECよりLinuxサービスセットの購入が必要です。同一メジャーバージョン内での対応となります。
*6 BTOインストール不可。NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux On Express5800」を参照願います。
*7 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。